

# 成都华微电子科技股份有限公司

## 关于公司 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案 的半年度评估报告

成都华微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）致力于通过科技创新和管理策略的持续优化增强核心竞争优势，坚信通过系统化的组织发展策略，提升综合实力，实现均衡发展，致力于构建一个长远、稳固且可持续的价值创造体系，以确保投资者能够获得稳健且持续的回报。公司始终保持对投资者高度负责的态度，通过不懈的努力和创新，为投资者带来长远的利益，公司于 2024 年 4 月 15 日发布了《成都华微电子科技股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”），旨在努力实现经营业绩持续稳定的增长，为客户、股东、员工及其他社会各方创造价值，积极回报利益相关方。

2024 年上半年，行动方案主要举措的进展及成效情况如下：

### 一、加强科技创新，提升核心竞争力

公司专注于特种集成电路研发、设计、测试与销售，以提供信号处理与控制系统的整体解决方案为产业发展方向，致力于成为国家级集成电路科研、生产龙头企业和骨干力量，助力国家特种集成电路行业的长远发展。

公司高度重视对产品及技术的研发投入，2024 年上半年公

司研发支出占营业收入的比例为 26.25%，较上年同期增加 3.16 个百分点。在主营业务方向上新申请发明专利 21 件，集成电路布图设计 13 件，软件著作权 4 件；新获批授权发明专利 3 件，集成电路布图设计 13 件。截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计获得境内发明专利 108 项，境外发明专利 5 项，集成电路布图设计权 203 项，软件著作权 29 项。公司研发人员占公司总人员比例为 41.15%，公司的研发能力得到持续提升，实施行动方案以来，公司现有产品性能得到持续提高，研发产品种类得到持续拓宽，各大类产品研发进程推进有序，公司重点投入的研发项目进展与预计取得的成果如下：

序号	项目名称	本期投入金额（万元）	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	高性能 FPGA	2,389.25	已形成五百万门到七千万门级 FPGA 谱系化产品；亿门级大规模 FPGA 以及集成高速 ADC/DAC，CPU 和并行大规模 eFPGA 的高集成度 FPGA 产品及配套 EDA 软件开发工具正在研发中。	集成高速 ADC/DAC、CPU 和信号处理定制加速单元，实现大带宽信号处理高性能处理平台。	国内领先	数据处理、5G 通信、卫星通信、人工智能加速等大带宽信号处理计算平台等领域。
2	高速数据转换（ADC/DAC）芯片	642.49	已形成 12 位 6GSPS 高速高精度 ADC 和 8 位 64G 超高速 ADC 等谱系化产品，且已实现小批量供货；单通道 12 位 12G 高速高精度 ADC 已经形成初样；4 通道 12 位 16G、	面向感知、测控、通信等宽频谱射频频直采先进收发架构应用需求。	国际先进	电磁频谱、卫星激光通信，通感一体化，高端测控仪器仪表等

			12位40G高速高精度ADC和单通道10位128G超高速ADDA正在研发。			领域。
3	智能异构系统（SoC）芯片	59.77	已完成一款智能异构SoC原型样片研制和测试，突破智能加速处理器和并行大容量可编程架构设计等关键技术，正在进行智能异构SoC量产产品的研发。	集成CPU、GPU、NPU以及eFPGA等核心IP，实现异构多核协同处理，形成高效处理标量、矢量和张量等多种计算的灵活高能效比计算平台。	国内领先	机器人、无人机、车载等嵌入式计算平台等领域。
4	高精度数据转换（ADC/DAC）芯片	1,354.43	已完成一款32bit超高精度ADC产品研制，突破了超低失调和大动态范围设计等关键技术，正在进行更高采样率、更低噪声电压和集成可变增益放大器、可编程采样率和空间高可靠性设计等方面的扩展设计。	集成高阶调制器、可编程增益放大器、高精度基准源等可复用核心电路，形成精度高、采样率和输入范围可配置的通用AD转换器产品。	国内领先	工业控制、陀螺、加速度计、热电偶、环境探测等领域。
5	微控制器芯片（MCU）	107.31	已形成低功耗、通用、高性能的低中高全系列产品体系，达到供货阶段，正在研制超低功耗系列和高性能计算系列微控制器。	形成特殊集成电路最完整谱系产品，高性能计算在微控制器领域应用落地。	国内领先	电机控制、车载等嵌入式控制领域。
6	电源管理芯片	1,840.15	已形成快速瞬态响应、超低噪声LDO电压调整器和高功率密度高效率DC-DC转换器谱系化产品，实现批量供货。面向高速转换器供电的大电流LDO电压调整器产品	面向高速通信和高速数据处理大电流LDO输出电流达到5A，高压大功率智能驱动控制器输	国内领先	高速通信、数据采集、伺服控制、精密测量等领域。

			和高功率高压智能驱动控制器产品正在研发。	入电压达到600V。		
7	总线接口芯片	947.73	已形成RS232/422/485协议、245总线、LVDS等接口谱系化产品,且已实现批量供货,完成订单过亿元。CAN总线收发器、有源滤波器方向多款典型产品已经定型并小批量供货。	开发35KV高等级ESD结构、宽电源域输入端口、高数据率驱动器等设计,形成功能全面、应用灵活的接口产品库。	国内领先	信号传输、通信系统、计算机系统等领域。

## 二、募投项目持续推进，紧抓重点项目进度

截止2024年6月30日，公司募投项目累计投入34,741.09万元（未包含补充流动资金项目部分），针对“芯片研发及产业化”项目，公司2024年上半年共投入11,719.99万元，投资进度为15.63%，未来公司将继续就高性能FPGA、高速高精度ADC、自适应智能SoC等三个方向的产品研发进行持续投入，尽早完成产品研发并实现产业化。在“高端集成电路研发及产业基地”项目上，公司2024年上半年共投入23,021.10万元，投资进度为41.86%，其项目预计将于2027年2月达到预定可使用状态，届时将建成检测中心和研发中心，助力公司打造集设计、测试、应用开发为一体的高端集成电路产业平台，强化巩固公司在特种集成电路领域的核心地位。

## 三、重视投资者回报，稳定投资者预期

截至本报告披露日，公司已完成实施2023年现金分红。公司已于2024年6月18日发放了2023年度现金红利，每10股派

发现金红利 1.12 元人民币（含税），合计派发现金红利 71,326,866.91 元，占 2023 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润合计数比例约 22.93%。

未来，公司将根据所处发展阶段，平衡好资本开支、经营性资金与现金分红需求，兼顾投资者的短期利益和长期利益，按照法律法规以及《成都华微电子科技股份有限公司章程》《公司上市后三年股东分红回报规划》等关于现金分红的规定，建立长期、稳定、连续的分红机制，及时回馈投资者。

#### **四、强化公司治理，促进长期稳定发展**

公司一贯重视在企业经营和生产活动中“关键少数”的关键角色，并致力于不断加强其履行职责的责任感。公司支持董事、监事及高级管理人员积极参加由监管机构组织的线上与线下培训。在监管政策发生重大调整之际，公司将主动组织并开展相关培训，以增强“关键少数”对证券市场法律法规的深入理解，丰富其合规知识，紧跟监管政策的最新动向，旨在不断提升董事会成员、监事会成员及高级管理人员的履职效能，以及相关业务人员的专业素养，同时不断提高其合规意识，以确保公司的规范运作，有效预防和控制公司治理风险。

为充分发挥独立董事与外部董事在公司治理中的关键作用，公司在今年上半年对《独立董事工作制度》进行了修订与完善。除定期召开的三会会议外，公司还特别组织独立董事与外部董事深入公司进行实地考察，以全面了解公司的经营状况，组织召开

了董事会与经营层管理的沟通专题会议，会议集中讨论了市场形势分析、业务结构的优化调整、人力资源管理与组织发展、风险管理与内部控制体系的构建等关键议题。这一系列措施旨在提升公司的战略引领力和管控能力，从而推动公司治理水平的整体提升。

今年上半年，共召开了董事会审计委员会会议 3 次，提名委员会会议、战略委员会会议、薪酬与考核委员会会议及独立董事专门会议各 1 次，有效发挥专门委员会和独立董事的作用，提高董事会的治理能力，完善公司治理，推动公司高质量发展。

未来，公司将根据国家法律法规变化及监管部门要求，结合企业实际情况，不断强化精细化管理，持续完善制度建设，力求以规范的治理结构、健全的制度、规范的流程、有效的内控，推动公司行稳致远。

## **五、提升信披质量，增强投资者沟通效能**

公司对信息披露工作给予极高重视，并严格遵守信息披露的真实性、准确性、完整性、时效性及公平性原则。公司不断优化与投资者沟通的机制，采用多种方式与投资者保持密切的沟通与交流。自行动计划实施以来，公司已通过上海证券交易所路演中心正式举办了 2023 年度及 2024 年第一季度的业绩说明会，与投资者就公司的经营成果和财务状况进行了深入的交流与讨论。

在确保信息披露质量的基础上，公司通过上海证券交易所 e 互动平台、电话、电子邮件等日常沟通渠道，与投资者保持畅通

的交流。通过增加与投资者的沟通频率，以帮助投资者更全面地了解公司、熟悉公司的业务和文化，并增强对公司的信任与认同。

未来公司将继续全面提升公司治理、管理水平，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳健康运行。

行动方案的实施未来可能会受到国内外市场环境因素、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

成都华微电子科技股份有限公司董事会

2024年8月28日